证券简称：中富电路　　证券代码：300814

深圳中富电路股份有限公司

SHENZHEN JOVE ENTERPRISE LIMITED

（广东省深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路 8 号）

向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告

（二次修订稿）

二〇二六年十一月

一、本次募集资金使用计划

本次发行股票的募集资金总额不超过人民币 83,800.00 万元（含本数，已扣除本次发行首次董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资 600.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目	74,020.52	60,000.00
2	数字化升级建设项目	12,763.01	8,000.00
3	补充流动资金	15,800.00	15,800.00
合计		**102,583.53**	**83,800.00**

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有或自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析

（一）鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目

1、项目概况

为积极响应国家产业政策，加速布局 AI 服务器及高端算力硬件领域高端印制电路板业务，全面提升公司核心竞争力与行业地位，公司拟在广东鹤山投资建设 AI 用 PCB 产线改扩建项目，本项目由发行人全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司负责实施，总投资额为 74,020.52 万元。本项目紧密围绕公司主营业务开展，可以强化公司在 AI 高端算力、数据中心基础设施等场景的产品供给与技术支撑，持续提升公司在高端 PCB 赛道的综合竞争力，增强公司的盈利能力与长期发展潜力。

2、项目必要性

（1）积极响应国家产业政策，助力公司高端化转型，提升产业链竞争力

近年来，国家高度重视新一代信息技术产业发展，先后出台《电子信息制造业数字化转型实施方案》《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》《制造业数字化转型行动方案》等一系列政策，明确支持推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料。印制电路板行业作为电子信息产业的核心基础元器件是支撑电子信息设备发展的关键载体，逐步向高端化、智能化、绿色化转型，其高端化发展直接关系到下游电子信息产业的核心竞争力。

公司作为国内 PCB 行业的骨干企业，始终紧跟国家产业政策导向，积极践行产业升级责任，进行高端 PCB 产品研发与生产。本次鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目，聚焦 AI 服务器电源、算力基础设施、智能汽车等高端 PCB 产品，同步布局精密制造、系统集成（器件埋入）、厚铜载板功率传输等技术储备，契合国家 PCB 行业高端化、自主化发展战略，既是公司响应产业政策的具体举措，也是加速高端技术突破与产能落地的关键行动，推动国内 PCB 行业突破高端技术壁垒、提升产业链整体竞争力。

（2）紧跟下游市场需求机遇，匹配战略客户订单增长，突破高端产能瓶颈

当前全球电子设备向智能化、高性能、高功率、小型化方向迭代升级，下游 AI 服务器电源、工业控制、高速通信等领域需求持续旺盛，带动高端印制电路板市场需求稳步释放。作为国内 PCB 行业的核心企业之一，公司凭借多年的技术积累与品质管控，已深度绑定台达电子、威迈斯、嘉龙海杰、比亚迪、Vertiv 等全球头部电源或汽车厂商，建立了长期稳定的战略合作关系，成为 AI 服务器电源 PCB 产品、高速通信、智能汽车产品的核心供应商。随着下游客户业务规模的持续扩张，其对高端 PCB 产品的采购需求逐年攀升，而公司现有高端产能已处于饱和状态，已无法满足核心客户批量订单的及时交付需求，产能瓶颈已成为制约公司进一步拓展高端市场、巩固客户合作关系的关键因素。

本次鹤山中富 PCB 产线改扩建项目，业务重心聚焦 AI 服务器电源 PCB 核心赛道，同时统筹布局高速通信 PCB 产能储备，产品定位贴合下游行业发展趋势，精准对接主流核心客户实际订单诉求。项目依托厂区现有生产设施开展设

备升级、工艺优化与产线改造，稳步扩充高端 PCB 有效产能，进一步调整完善整体产能结构，切实缓解目前高端产品产能供给不足的发展瓶颈。项目建成投产后，能够有效提升订单处理效率，保障产品交付时效与供货品质稳定性，持续加深与核心客户的合作联结，稳固现有合作关系。依托产能实力提升，公司可进一步紧跟重大市场机遇，扩大自身在 AI 服务器电源 PCB 细分领域的市场占有率，全面增强综合市场竞争力，为企业中长期业务稳步扩张、经营规模持续增长夯实产能根基。

（3）优化公司产能布局，推动高端技术突破，破解行业同质化竞争困境

当前国内 PCB 行业呈现明显的两极分化格局，中低端 PCB 市场同质化竞争激烈，产品附加值偏低，盈利能力持续承压；而高端 PCB 市场由于技术壁垒高、研发投入大、生产工艺复杂，行业准入门槛较高，目前供给缺口较大，尤其是 AI 服务器电源 PCB、封装载板、高速通信 PCB 等高端细分领域，核心技术与优质产能主要集中于少数头部企业，市场竞争格局相对宽松。公司深耕 PCB 行业多年，已在深圳、江门、泰国布局多个生产基地，形成了一定的产能规模与区域协同优势。

鹤山中富 AI 应用 PCB 产线改扩建项目建成后，能够进一步补齐公司高端 PCB 产能布局短板，统筹协调各生产基地分工定位，实现产能资源统筹调配与优势互补，全面提升整体生产运营效率。项目重点开展 AI 服务器电源 PCB 产品规模化生产。依托产线升级契机，公司将加大高端印制电路板技术研发投入，持续优化高阶 HDI、厚铜板材、高多层线路板、高频高速板材及内埋器件加工等核心工艺，稳步精进高端产品研发实力与智能制造水准，带动产品品类向高附加值方向进阶，依托差异化竞争优势推动企业实现稳健高质量发展。

基于上述条件，公司管理层经过充分调研与审慎研究，认为本次募集资金投资项目的实施将进一步优化公司产品结构、增强公司市场竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目的实施具备必要性。

3、项目可行性

（1）友好的产业政策为本项目实施提供良好的政策环境

印制电路板（PCB）作为各类电子系统不可或缺的基础互联载体，是支撑数字经济、新型工业化与电子信息产业自主可控的战略性、基础性、先导性支柱产业，长期受到国家产业政策的重点扶持与引导。国家“十四五”规划明确提出加快壮大新一代信息技术、新能源汽车、人工智能、工业互联网等战略性新兴产业，为 PCB 行业提供了长期发展框架。在此基础上，国务院及各部委先后出台《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035 年）》《关于培育壮大新质生产力推进新型工业化的指导意见》《“人工智能+制造”专项行动实施意见》《电子信息制造业数字化转型实施方案》等一系列政策，持续推动高速通信、新能源汽车、物联网、工业互联网、算力基础设施等 PCB 下游应用领域快速升级，提出加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给，打造新兴支柱产业，加快航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，并推动具身智能、第六代移动通信等未来产业成为新的经济增长点。

近年来，PCB 行业政策进一步向高质量、高端化、绿色化聚焦，工信部发布《印制电路板行业规范条件（2025 年本）》《印制电路板行业高质量发展行动计划（2025—2028 年）》，引导行业严控低端产能扩张、强化研发创新、提升绿色制造与智能制造水平，推动 PCB 向高频高速、高阶 HDI、高多层、IC 载板、AI 服务器板等高端方向升级。多层次政策体系协同发力，持续拓宽 PCB 市场需求空间、优化行业竞争格局，为我国 PCB 产业高质量发展与国产替代提供了坚实支撑与长期有利的发展环境。

（2）优质的客户资源为项目产能消化奠定稳定的市场基础

公司凭借技术逐步积累和与客户的长期合作，在通信、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装等领域拥有了较为稳定的客户资源，与众多国内外知名企业保持长期稳定的合作关系。目前公司与台达电子、威迈斯、Vertiv、NCAB、AE、Asteelflash、Lacroix、Lenze、Schneider、Flex Power、Jabil、嘉龙海杰、比亚迪、铂科新材、瑞声、歌尔、航嘉、立讯等通信、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装等领域的国内外知名企业保持长期稳定的合作关系。

为了加大对 AI 用 PCB 市场的开发力度，公司陆续通过了多家知名客户的供应商认证体系认证，成功开拓了诸如台达电子、伟创力、铂科新材、新雷能、沛

塬电子、美国芯源（MPS）等多家 AI 服务器客户，同时与多家境外大型云厂商客户及其供应商进行了富有成效的接触、试样及联合研发，参与大客户新产品预研，为本次项目的实施奠定了稳定的市场基础。

（3）深厚的技术积淀为项目建设提供重要保障

公司深耕 PCB 领域多年，针对 AI 硬件高功率密度、精密散热、异构集成的核心需求，已构建起贯穿原材料加工、器件级封装至系统集成的全链条核心技术体系，在 AI 电源板精密制造、厚铜载板功率传输、埋器件系统集成等领域形成关键技术储备，相关技术已实现精密尺寸控制、小间距线路、器件嵌埋等核心突破，为本次募投项目建设及顺利实施提供了坚实的技术保障，有效保障项目技术可行性。

公司在精密制造（含 PCB 平面度、尺寸公差控制）、功率传输（厚铜线路优化）、系统集成（器件埋入）等核心技术领域已实现关键突破，相关技术已具备规模化生产条件，能够精准匹配本次募投项目高端 AI 服务器电源相关产品的技术要求，有效降低项目技术落地风险，进一步夯实项目可行性基础。依托成熟的技术积淀与规模化生产经验，公司可快速实现募投项目产能释放、产品稳定交付，确保项目投产后能够顺利达成预期目标，为公司项目建设提供了坚实的技术保障。

4、项目投资情况

本项目预计总投资为 74,020.52 万元，拟使用募集资金投入金额 60,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元、%

序号	项目	项目资金	占比	募集资金投入金额
一	**建设投资**	**73,068.13**	**98.71**	60,000.00
1.1	场地购置费	3,113.64	4.21	
1.2	装修及配套工程费	4,379.51	5.92	
1.3	设备购置及安装	64,289.20	86.85	
1.4	设备安装费用	1,285.78	1.74	
二	**工程建设其他费用**	**952.39**	**1.29**	
三	**合计**	**74,020.52**	**100.00**	**60,000.00**

本次发行董事会决议前，该项目土地购置费已完成部分投入。该项目拟使用募集资金投入金额为 60,000.00 万元，募集资金计划用于建设投资中的场地购置费及设备购置费用，本次募集资金均用于董事会决议日后的项目资本性支出，不存在使用募集资金投入非资本性支出项目的情形。

5、项目实施主体

本项目由公司全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司负责实施。

6、项目预计实施时间

本项目计划实施周期为 24 个月。

7、项目效益预测情况

本项目运营期可实现年均营业收入 70,044.44 万元，年均净利润 8,576.81 万元，预期经济效益良好。

上述测算不构成公司的盈利预测，测算结果不等同对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，请投资者予以关注。

（二）数字化升级建设项目

1、项目概括

本项目拟依托公司现有信息化基础，围绕生产数字化、管理数字化及供应链数字化三大方向实施数字化系统升级。本项目拟由发行人及其全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司作为实施主体，总投资额为 12,763.01 万元，项目规划建设期为 24 个月。通过对核心功能模块的迭代优化与补充完善，推动数字化管理在公司全业务链条实现全域覆盖与深度渗透，助力公司持续强化精细化管理，并在此基础上强化产品全流程品质追溯能力，持续提升产品良率与制程稳定性，进而优化内部管理流程、降低综合运营成本，提升生产环节协同效率及公司整体运营管控水平。同时，本项目拟通过搭建智慧园区系统及园区配套机房建设，构建全方位、多层次的信息安全防护体系，增强数据资产安全与系统运行稳定性，夯

实公司数字化运营的底层技术基石，为公司业务高效、稳健运行提供坚实支撑，助力公司在数字化转型浪潮中构筑核心竞争优势。

2、项目必要性

（1）加强数字化能力升级建设，提升方式全流程追溯与柔性调度能力

公司专注于印制电路板的研发、生产与销售，产品广泛应用于通信设备、工业控制、汽车电子等核心领域，具备定制化程度高、产品品类丰富、订单交付周期短的经营特征。目前，公司境内外生产基地信息化体系仍处于基础建设并持续完善的阶段，各业务模块系统尚未实现深度数据协同，制程数据采集与品质追溯的精细化程度仍存在优化空间。本项目拟通过生产环节数字化升级建设，搭建覆盖订单接收、制程管控、成品出库全链条的数据采集与质量追溯体系，优化柔性化生产调度体系，全面提升公司对定制化订单的快速响应能力与产品交付品质，适配 PCB 产品高频、高速、高密度的高端化发展趋势。

（2）顺应行业数字化转型趋势，全面提升精细化管理水平与综合竞争力

当前 PCB 行业竞争格局已由传统产能规模竞争，转向数字化管控能力、产品品质保障能力及综合运营效率的竞争，行业内领先企业已率先完成智能制造与数字化体系布局。同时，伴随 AI 服务器、高速通信等下游高端应用领域对 PCB 产品层数、工艺精度及可靠性要求持续提升，产品生产制造复杂度日益提升，对企业全流程精细化管理提出更高要求。公司产品种类丰富、定制化程度较高，现已形成涵盖境内外生产的多基地运营格局，对跨部门、跨基地协同管理及资源统筹调度的依赖程度较高。本项目拟通过对现有信息化基础实施数字化升级，整合 MES、WMS、QMS、ERP 等核心业务系统，构建一体化数据管控平台，实现生产过程透明化管控与跨基地资源高效协同调度，补齐公司数字化运营短板，提升整体运营管理效率与精细化管理水平，缩小与行业领先企业的数字化差距，进一步巩固并提升公司市场地位与综合竞争力。

（3）优化成本管控体系，提升运营效率及综合盈利能力

公司 PCB 产品生产工序较长、工艺技术复杂度较高，成本管控贯穿研发设计、物料采购、生产制造及质量管理等全业务流程。目前公司已形成境内外多生

产基地协同布局，其中鹤山生产基地获评“江门数字化转型标杆车间”，数字化建设具备阶段性示范成效；泰国生产基地在建设阶段同步部署 MES、WMS 等核心数字化系统，初步实现订单流转、制程追溯及物流协同等基础功能。尽管公司在数字化转型方面已取得阶段性进展，但各业务系统间的数据协同效率仍有优化空间。基于以上，本项目拟通过生产流程优化、管理系统迭代升级及供应链数字化建设，推动核心业务系统间数据贯通，实现从订单接收到成品出库的全流程数据互联互通，提升资源配置效率与跨基地、跨部门流程协同效能，持续优化产品交付能力，提升高附加值产品占比，增强应对原材料价格波动的成本管控能力，进而提升公司综合盈利能力。

（4）强化信息安全建设，支撑业务高效稳定运转

伴随公司数字化程度提升，生产数据、客户信息、工艺参数等核心数据资产规模持续增长，对信息安全保障能力提出更高要求。本项目拟通过搭建智慧园区系统及园区配套机房建设，完善数据备份、权限管理、网络安全防护机制，构建全方位、多层次的信息安全防护体系，增强数据资产安全与系统运行稳定性，夯实公司数字化运营的底层技术基石，为公司业务高效、稳健运行提供坚实支撑，助力公司在数字化转型浪潮中构筑核心竞争优势。

综上所述，本次募集资金投资项目具有合理性和必要性。

3、项目可行性

（1）国家相关政策为项目实施提供良好的产业环境

近年来，我国陆续出台相关政策支持制造业数字化转型，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026 年）》提出把握数字化、网络化、智能化发展大势，充分发挥我国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔优势，加快数智技术创新；《信息化和工业化融合 2025 年工作要点》明确推进数字化转型，引导规上工业企业、专精特新中小企业加快数字化改造；《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》要求深入推动数字化转型，强化软硬协同，加快新一代信息技术在制造业全行业全链条普及应用，编制重点产业链数字化转型场景图谱及要素清单，培育面向典型场景的数字化转型通用工具产品、

解决方案与服务商。本项目依托公司现有信息化基础，围绕生产数字化、管理数字化及供应链数字化三大方向实施数字化系统升级，属于信息化升级建设项目，符合国家及行业相关产业政策导向。

（2）PCB 行业数字化转型技术体系趋于成熟，项目实施风险可控

目前，PCB 行业数字化转型所涉及的生产装备联网、数据采集与监控、制造执行系统、智能质量检测、智能排产、供应链协同管理及工业互联网平台等关键技术路径较清晰，相关软硬件产品与解决方案成熟度较高，行业内已形成较为完善的技术服务与系统集成生态，头部企业数字化工厂建设与运营实践经验丰富，技术应用具备良好的可复制性与可推广性。本项目在公司现有信息化建设基础上实施，技术选型贴合行业成熟应用方案，实施流程规范可控，项目整体技术可行性较高，实施风险可控。

（3）公司具备数字化升级建设的软硬件基础

公司依托数字化建设基础及前期数字化建设积淀，已构建覆盖生产、管理、人才的多层次数字化支撑体系，为本次数字化系统升级项目实施奠定坚实基础。生产数字化方面，公司全资子公司鹤山生产基地智能化车间获评江门市制造业数字化转型标杆示范车间；泰国生产基地在规划建设阶段即同步部署 MES、WMS 等核心数字化系统，已实现订单流转、生产过程追溯、工艺配方管控及跨境物流协同等功能，境内外基地均积累了成熟可复制的数字化建设与运营经验。管理数字化方面，公司已上线 OA、财务、人力资源等一体化管理信息系统，全面覆盖核心业务与管理职能模块；同时公司已通过 ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO13485 及 ISO27001 等多项国际管理体系认证，形成标准化、规范化的管理流程，为管理数字化升级提供完备的制度保障与系统支撑。人才储备方面，公司组建专业化信息化技术团队，实施专业人才梯队培养，核心人员具备多年 PCB 行业信息系统规划、部署与运维经验，深度契合公司业务流程与经营管理需求，能够为项目全周期实施提供稳定可靠的专业技术保障。

4、项目投资情况

本项目预计总投资为 12,763.01 万元，拟使用募集资金投入金额 8,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元、%

序号	项目	项目资金	占比	募集资金投入金额
一	**资产投资**	**12,512.75**	**98.04**	**8,000.00**
1.1	软件购置及实施费	10,247.75	80.29	
1.2	设备购置及安装	2,195.00	17.20	
1.3	装修及配套工程费	70.00	0.55	
二	**预备费**	**250.26**	**1.96**	-
合计		**12,763.01**	**100.00**	**8,000.00**

该项目拟使用募集资金投入金额为 8,000.00 万元，募集资金主要用于项目所属的软件购置及实施费用，本次募集资金均用于董事会决议日后的项目资本性支出，不存在使用募集资金投入非资本性支出项目的情形。

5、项目实施主体

本项目由深圳中富电路股份有限公司及其子公司鹤山市中富兴业电路有限公司负责实施。

6、项目预计实施时间

本项目计划实施周期为 24 个月。

7、项目效益预测情况

本项目为数字化升级建设项目，不涉及产能增加，不单独产生直接经济效益。本项目拟依托公司现有信息化基础，围绕生产数字化、管理数字化及供应链数字化三大方向实施数字化系统升级。项目实施后，公司将稳步提升运营管理效率、信息化水平及产品良率与质量，有利于公司构建精益制造体系，实现降本增效目标。

（三）补充流动资金

1、项目概括

根据公司经营发展规划，公司拟使用募集资金 15,800.00 万元用于补充流动资金，有助于缓解公司快速发展过程中对资金的需求压力，保证公司可持续发展。

2、项目必要性和可行性

（1）项目必要性

PCB 行业属于资金密集型产业，整体资金需求较高。一方面，PCB 产品生产需配备各类专业生产及检测设备，且公司产品品类丰富、定制化属性突出，需根据产品结构、基材材质、性能要求及客户需求适配不同生产设备，设备投入需求较大；另一方面，伴随业务规模扩大与市场竞争加剧，公司在原材料采购、生产制造、市场拓展等环节的资金投入持续增加。同时，受业务模式及结算政策等因素影响，公司应收账款、存货等经营性资产规模较大，对流动资金形成一定占用。本次募投项目实施后，将有助于提升运营效率，改善公司经营性现金流状况，保障核心业务持续经营。

（2）项目可行性

本次募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构关于上市公司规范运作的相关规定，建立健全关于各项公司治理制度，并在日常生产经营活动过程中通过不断改进和完善，形成了符合上市公司治理要求的、规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司对募集资金的存储、使用、管理与监督等作出了明确规定，确保公司募集资金的依法、合规使用。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次募集资金对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、公司战略规划方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于优化公司产能布局、实现产能结构升级改造、提升公司数字化水平，对公司拓展境外市场份额、打造核心竞争力、寻求新的利润增长点具有重要意义。

（二）本次募集资金对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产规模将相应提高，资金实力将有所增强。公司本次发行有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。本次募集资金

投资项目达到预期目标需要一定的时间，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着募投项目的顺利实施，公司的业务规模和盈利能力将进一步提高。

四、可行性分析结论

本次募集资金投资项目的建设符合国家产业政策导向和公司战略发展规划，具有良好的经济效益和社会效益。公司在客户资源、管理团队、实施经验等资源上的储备为本次募集资金投资项目的顺利实施提供了有效保障。本次募集资金投资项目的实施将有利于公司实现产能结构升级、提升公司数字化水平、补充运营所需资金，提高公司的核心竞争力，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目的实施具备必要性和可行性。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日